

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2025-033

深圳精智达技术股份有限公司

关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目：先进封装设备研发项目。
- 投资金额及资金来源：本项目总投资额人民币 29,960.74 万元，拟全部使用超募资金进行投资。
- 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：尽管已对本次超募资金拟投资建设的项目进行了充分的可行性研究和论证，但仍不排除项目实施过程中可能出现市场竞争及产业化风险、管理风险、技术研发风险、人力资源风险等风险。

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“精智达”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司与南京浦口经济开发区管理委员会（以下简称“浦口经开区管委会”）签署《投资协议》，拟投入建设先进封装设备研发项目；同意公司使用 29,960.74 万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益，下同）用于上述项目投资。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本次投资尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发

行费用(不含增值税)人民币 11,266.79 万元后,募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2023]000414 号”《验资报告》。

二、募投项目及超募资金情况

根据公司《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告》(2025-012),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	实施主体
1	新一代显示器件检测设备研发项目	19,804.75	19,800.00	精智达
2	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	16,205.67	16,200.00	合肥精智达集成电路技术有限公司
				深圳精智达半导体技术有限公司
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	精智达
	合计	60,010.42	60,000.00	-

在本次拟使用超募资金投资项目前,除使用部分闲置募集资金进行现金管理外,公司不存在使用超募资金进行永久补流、投资建设其他项目的情况。

三、项目的基本情况

为了提高公司募集资金使用效能,公司拟通过全资子公司南京精智达技术有限公司(以下简称“南京精智达”)实施,并拟使用部分超募资金投资建设下列项目(以下简称“本次募投项目”或者“项目”):

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟使用超募资金投入金额	实施主体
先进封装设备研发项目	29,960.74	29,960.74	南京精智达技术有限公司

本次募投项目具体情况如下：

（一）本次募投项目基本情况

1、实施主体：南京精智达技术有限公司

2、实施主体股东：深圳精智达技术股份有限公司（100.00%）

3、项目名称：先进封装设备研发项目

4、实施地点：南京市浦口区浦口经济开发区

5、建设周期：本项目建设周期三年

6、建设内容：南京精智达拟通过扩展研发场地、购置研发设备、增加研发人员投入等手段，结合未来市场需求，持续投入包括探针卡、探针台、分选机、键合设备等先进封装设备研发试制，以期提升公司技术竞争能力，在一定程度上满足行业客户对先进封装设备的需求，建立在国内半导体设备行业的优势地位。

7、资金来源及投资金额：公司拟使用超募资金向南京精智达实缴注册资本及提供借款的方式实施该项目。本项目总投资额人民币29,960.74 万元，拟全部使用超募资金。公司将按照相关规定履行备案、环评（如需）等相关手续。项目预算具体投资概算如下：

单位：万元

序号	项目	拟投资金额	占比
1	场地租赁及装修	8,911.00	29.74%
2	硬件设备购置	6,100.67	20.36%
3	软件设备购置	750.00	2.50%
4	研发人员费用	6,062.40	20.23%
5	试制材料费用	6,645.00	22.18%
6	其他研发费用	1,186.64	3.96%
7	预备费	305.03	1.02%
合计		29,960.74	100.00%

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

本次使用超募资金投资新项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

（二）本次募投项目实施主体概况

项目实施主体：南京精智达技术有限公司

子公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

注册地址：江苏省南京市浦口区浦口经济开发区双峰路69号A座901

公司出资方式：货币出资

公司持股比例：100%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子专用设备制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）本次募投项目的必要性及可行性分析

1、本次募投项目实施的必要性

（1）集成电路产业发展需求

随着硅芯片将达到物理极限，通过缩小晶体管实现芯片性能提升成本越来越高，以芯粒异质集成为核心的先进封装技术，成为集成电路发展的关键路径和突破口。相比传统封装，先进封装具有小型化、轻薄化、高密度、低功耗和功能融合等优点，不仅可以提升性能、拓展功能、优化形态、降低成本。先进封装技术的应用范围广泛，涵盖了人工智能、移动设备、高性能计算、物联网等多个领域。现代智能手机中大量使用了CSP和3D封装技术，以实现高性能、低功耗和小尺寸的目标；在高性能计算领域，2.5D和3D集成技术被广泛应用于处理器和存储器的封装，显著提升了计算性能和数据传输效率，为人工智能时代的高算力需求奠定基础。

尤其是对于中国大陆市场，在取得先进制程设备日益变得困难的背景下，先

进制程晶圆制造产业化短期受阻，先进封装有望成为技术演进和实现产业化的重要路线。

本项目战略布局先进封装领域，助力国内集成电路行业紧跟产业先进发展趋势，在封装测试环节提升我国集成电路行业的技术水平，为国家半导体发展战略的实现做出贡献。

(2) 提升设备自主化水平

集成电路先进封装设备行业门槛较高，相关技术发展日新月异，目前仍处于国外企业寡头垄断局面，高端设备仍严重依赖进口。为了实现我国集成电路整体产业的自主发展，满足对先进封装设备的国产化需求，振兴民族核心工业，中国必须拥有自主知识产权高端先进封装设备产品。发展以先进封装设备为代表的半导体设备有助于弥补中国产业升级核心环节的不足，能在一定程度上推动国内集成电路产业链各个环节的发展，促进产业上下游协作关系的形成。

本项目有助于打造我国自主技术的先进封装设备产品，形成关键设备供货能力，促进上下游产业链企业的协调发展，提升我国半导体存储器件产业的自主发展能力。

(3) 系统化全站点服务能力成为测试设备厂商核心竞争力

系统化全站点服务能力意味着测试设备厂商能够提供涵盖各测试设备品类及其硬件、软件、算法、数据分析等在内的全面解决方案。具备系统化全站点服务能力的测试设备厂商能够服务客户的不同需求，提供由多品类、高精度设备构成的完整测试系统解决方案，灵活配置和定制测试系统，提高设备的兼容性和适应性。由于DRAM 厂商持续迭代升级芯片，由多品类设备构成的全站点测试系统可以通过设备升级、硬件更换、软件迭代等多种方式，快速实现对不同产品的测试切换，提升研发创新品质，降低客户使用成本。

目前，精智达已具备DRAM CP测试机、DRAM FT测试机、DRAM老化测试及修复设备以及测试过程中的探针卡、老化治具板等附件配件等后道测试设备产品线，本项目拟研发产品将进一步丰富精智达产品布局，形成并完善系统化全站点服务能力。

2、本次募投项目实施的可行性

(1) 产业发展政策环境持续优化

近年来，国家及地方从研发、人才、知识产权、进出口、市场应用、财税、投融资、国际合作等维度制定多项促进政策，进一步优化半导体产业的发展环境，鼓励半导体产业提升创新能力，打破国外垄断，实现跨越式发展。根据国家战略发展规划，预计未来国家将出台更多有利于半导体行业的支持政策，为本项目的顺利实施提供充分的政策支持与保障。

(2) 集成电路先进封装设备市场广阔

Yole预计，全球先进封装市场规模有望从2023年的468.3亿美元增长到2028年的785.5亿美元，先进封装占封装市场比例预计由2022年的46.6%提升至2028年的54.8%。随着国内龙头企业紧跟产业趋势进行投资建设，集成电路先进封装产业不断壮大，国内新投资产线陆续进入设备采购高峰，对于相关专用设备，尤其是对高端先进封装设备的需求将进一步增加。从国内半导体产业发展态势来看，存储器件是驱动近年来行业资本开支的主要动力，公司已与国内龙头企业形成长期合作，未来基于产业发展趋势及重点客户发展规划，公司在集成电路先进封装设备上重点布局，具有较强产业针对性。

(3) 公司具备开展相关技术研发的人力物力储备

近年来，公司持续投入半导体存储设备的研发和产业化工作，在测试设备领域已形成较为完善的业务布局。2023年完成科创板上市以来，公司加大对半导体领域的投资力度，建立和完善相应的研发、生产、客户服务等体系，积累大量集成电路专用设备的知识产权和关键技术。

① 技术积累

精智达在ALPG处理器及编译器、高精度TG时序生成器、高速信号互联技术、电测试接口单元及专用集成电路设计技术、DRAM测试及修复技术、多通道信号自动校准技术、宽温区高均匀度老化炉体控制等方面有丰富的经验积累，并在此基础上开展了针对半导体存储器后道测试工艺的全覆盖产品研发。

② 产品经验

精智达长期研发和生产多款应用于泛半导体领域多款测试及检测设备，包括 DRAM 老化测试及修复设备、DRAM 通用测试验证系统、探针卡、Cell/Module 老化设备、Micro LED Wafer Test 设备、Cell/Module 光学检测设备等产品已在客户产线量产应用，多款应用于 DRAM 产线的 CP、FT 测试机已进入客户验证阶段、部分设备已取得订单，为先进封装设备研发及后续量产积累产品经验。

③ 客户合作

先进封装系行业发展重要方向，精智达多个长期合作的客户均已布局先进封装领域，存在相关设备需求。基于长期合作基础，公司根据客户实际需求并结合自身生产、技术经验，将聚焦研发符合产业发展方向、技术演进方向、客户应用方向的产品。

④ 组织架构

截至2024年末，公司已有研发人员278人，占公司总人数达到47%，并持续扩充研发团队。南京精智达技术有限公司及深圳精智达半导体技术有限公司分别于2024年12月及2025年1月完成设立，为公司进一步加强半导体业务提供组织保障。

本项目将基于公司长期积累的技术及市场基础，积极响应重点客户业务发展需求，技术及市场可行性较强。

四、《投资协议》主要内容

公司（以下称“乙方”）拟就本次投资项目与浦口经开区管委会（以下称“甲方”）签署《投资协议书》，上述协议主要内容如下：

（一）交易对手方介绍

名称：南京浦口经济开发区管理委员会

机构性质：机关单位

住所：江苏省南京市浦口区兰花路8号

法定代表人/负责人：董乔忠

关联关系说明：南京浦口经济开发区管理委员会与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）投资总额：乙方直接投资不超过叁亿元（小写：3亿元）。

（三）建设地址：江苏省南京市浦口区

（四）双方的权利及义务：乙方在项目建设过程中应遵守环保、安全生产、消防安全等法律法规，甲方协助、配合乙方做好有关行政审批事项。

（五）生效条件：本投资项目实施以乙方有权机构审议通过为前提。本协议自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字、加盖双方单位公章，经乙方有权机构审议通过后生效。

五、项目实施对公司的影响

公司使用部分超募资金投资建设新项目系根据公司发展战略制定，项目围绕行业发展趋势和市场需求，符合公司业务发展方向，可带动公司针对现有产品进行升级研发。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司未来发展产生积极影响。

六、项目风险分析

（一）市场竞争及产业化风险

随着需求的释放和升级，行业发展前景广阔、市场潜力巨大，目前国内外企业均开始重视先进封装带来的市场机遇，未来本项目有可能面临较为激烈的市场竞争，使本项目研发成果可能面临由于市场竞争带来的产业化风险。

（二）管理风险

经过多年技术沉淀与市场深耕，公司已构建起较为完善的内部控制与管理制度体系。公司注重人才战略布局，培养了一支专业化的管理团队，有效保障了公司的运营效率。随着本次项目的实施，公司业务版图将进一步拓展，业务结构与组织架构的复杂度有所提升，对公司的管理模式迭代、内控体系优化、技术创新

能力以及全球市场拓展能力提出了更高要求。若公司在管理体系升级、核心技术研发投入、人才梯队建设及市场竞争策略等方面无法实现同步提升，可能导致运营效率下降，进而对公司的可持续发展产生不利影响。

（三）技术研发风险

公司拥有一支经验丰富的技术人才队伍，积累了丰富的研发经验，在国内同行中具备较为突出的技术和研发优势。但随着下游应用市场的快速增长，其他竞争对手也逐步增加相关技术研发的投入，若公司在技术研发水平上不能紧跟国内外产品开发形势，将可能对本项目研发进度带来不利的影响。

（四）人力资源风险

随着公司规模的扩大，一方面，公司对专业管理人才和技术人才的需求将大量增加，而行业的快速发展导致市场对上述人才的需求也日趋增长。如果未来公司无法吸引优秀人才加入，或公司的核心人才流失严重，将对公司长期发展造成不利影响。

七、项目募集资金的管理

本次使用部分超募资金投资建设新项目的相关审批程序履行完成后，项目实施主体南京精智达将开立募集资金专用账户，专项存储拟投入的超募资金，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储三方监管协议，公司将根据新建项目的实施进度，在投入超募资金的总额范围内通过向南京精智达实缴注册资本及提供借款的方式以实施募投项目。公司将严格按照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

八、项目履行决策程序

（一）审议程序

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。此外，本次拟使用部分超募资金投资建设新项目事项尚需公司股东大会审议通过。

（二）董事会意见

董事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件相关规定，符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次超募资金的使用不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变其他募投项目募集资金投向的情形。同意使用部分超募资金投资建设新项目。

（三）监事会意见

监事会认为：本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件相关规定，符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次超募资金的使用不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变其他募投项目募集资金投向的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目。

九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：精智达本次拟使用部分超募资金投资建设新项目事项已经公司董事会及监事会审议通过，除尚需股东大会审议通过外，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科

创业板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度的规定。

综上，保荐机构对精智达本次拟使用部分超募资金投资建设新项目事项无异议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年4月26日